

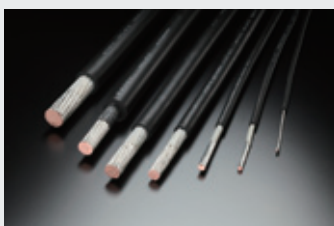


日立電線は、日本屈指の電線メーカーとして、電力施設用から一般建設用・産業用に至るまでさまざまな電線・ケーブルを供給しています。創業以来、蓄積してきた高い技術力と豊富な経験を活かして、お客様に最適な製品を提案しています。なお、当セグメントは、「産業システム・電力エネルギー」「光通信」の2つのSBU (Strategic Business Unit) から構成されています。

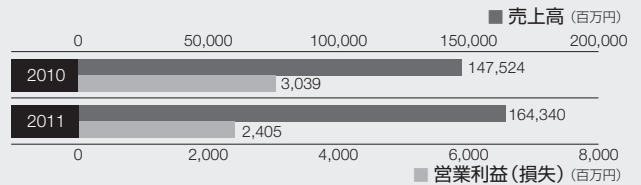
2012年3月期の当セグメントの業績は、売上高913億72百万円、営業損失2億8百万円でした。なお、当セグメントは決算期統一の影響により、売上高が15億6百万円増加、営業損失が69百万円減少しています。SBU別の売上高では、産業システム・電力エネルギーは、東日本大震災からの復旧需要等により震災影響による減少のあった前期を上回りました。光通信は、震災復旧需要の反動で第2・第3四半期は低調でしたが、第4四半期は在庫調整終了や復興需要立ち上がりにより増加し、通期では前期を上回りました。

主要製品一覧

- 産業システム・電力エネルギー：CVケーブル、OFケーブル、耐火・耐熱ケーブル、キャブタイヤケーブル、鉄道車両用電線・ケーブル、トオリ線他
- 光通信：光ファイバケーブル、メタル通信ケーブル他



難燃性ポリフレックス電線「MLFC」
*MLFCは、日立電線(株)の登録商標です。

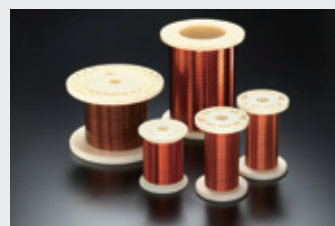


日立電線は、電線・ケーブルの開発・製造で培った技術力・ノウハウを活かして、高性能巻線や極細同軸ケーブル、電源ハーネス、プレーキホースなどを開発・提供しています。これら高機能製品は、エレクトロニクス機器や自動車電装品などの小型化・高性能化、省エネルギーに貢献しています。なお、当セグメントは、「自動車部品」「電子材料」「巻線製線」の3つのSBU (Strategic Business Unit) から構成されています。

2012年3月期の当セグメントの業績は、売上高1,643億40百万円、営業利益24億5百万円でした。なお、当セグメントは決算期統一の影響により、売上高が150億75百万円、営業利益が4億3百万円増加しています。SBU別の売上高では、自動車部品は、第2四半期以降自動車メーカーの生産が回復し順調に推移したことから前期を上回りました。電子材料は、エレクトロニクス市場・半導体市場の低迷等により減少しましたが、決算期統一の影響により前期を上回りました。巻線製線は、電装分野向けが順調に推移し前期を上回りました。

主要製品一覧

- 自動車部品：プレーキホース、ABS車輪速度センサ、ハイブリッド車用電源ハーネス、挟込み防止用感圧センサ他
- 機器用電線・配線部品：PVワイヤー、極細同軸ケーブル、医療用・産業ロボット用ケーブル、配線合理化製品 (FFC) 他
- 巻線：高占積率モータ用エナメル線、インバータサージ対応エナメル線、横巻線他



各種エナメル線

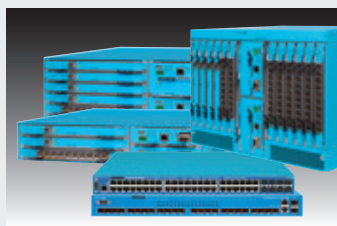


日立電線は、世界トップレベルのオプトエレクトロニクス技術や高周波・無線技術を活用して、通信事業者向けの情報ネットワーク機器、携帯電話基地局や地上デジタル放送のアンテナシステムなど、情報化社会の根幹を支えるさまざまな製品や技術、ソリューションを提供しています。また、ガリウムヒ素化合物半導体のエキスパートとして、光デバイス、電子デバイスの両分野で基板からエピタキシャルウェハまでを一貫生産しています。なお、当セグメントは、「情報ネットワーク」「ワイヤレスシステム」「化合物半導体」の3つのSBU (Strategic Business Unit) から構成されています。

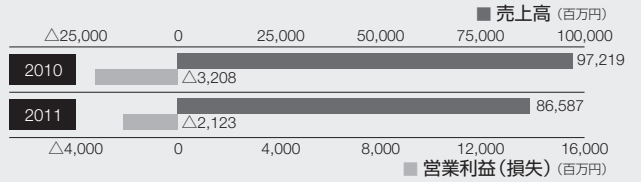
2012年3月期の当セグメントの業績は、売上高480億480万円、営業利益5億300万円でした。なお、当セグメントは、決算期統一の影響により、売上高が1億580万円増加、営業利益が200万円減少しています。SBU別の売上高では、情報ネットワークは、携帯電話通信事業者の設備投資需要等により前期を上回りました。ワイヤレスシステムは、携帯電話基地局向け需要の端境期が続いたことにより前期を下回りました。化合物半導体は、光デバイス用は需要減少により、高周波デバイス用は代替素材との競合により、前期を下回りました。

主要製品一覧

- 情報ネットワーク：イーサネットスイッチ、光トランシーバ、光伝送装置他
- ワイヤレスシステム：携帯電話基地局用アンテナシステム、地上デジタル放送用アンテナシステム、高周波同軸ケーブル他
- 化合物半導体：ガリウムヒ素基板・エピタキシャルウェハ、窒化ガリウム基板他



イーサネットスイッチ「APRESIA」(通信事業者向け、民間・公共向け)



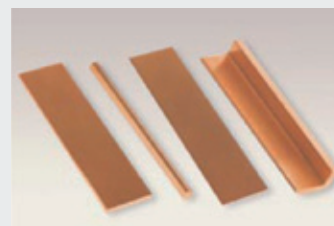
日立電線は、電線・ケーブル製造によって培った銅をはじめとする各種金属の加工技術や、合金技術を駆使して多彩な製品を開発・提供しています。銅条、リードフレーム、半導体用TAB*など、産業界のニーズにきめ細かく応える金属材料をラインアップしています。なお、当セグメントは、「銅条」「伸銅」「リードフレーム」「パッケージ材料」の4つのSBU (Strategic Business Unit) から構成されています。

2012年3月期の当セグメントの業績は、売上高865億870万円、営業損失21億230万円でした。なお、当セグメントでは、決算期統一の影響により、売上高が9億810万円、営業損失が730万円増加しています。SBU別の売上高では、銅条はエレクトロニクス市場・半導体市場向け製品の需要減少により前期を下回りました。リードフレームもエレクトロニクス市場・半導体市場の低迷の影響を受けましたが、決算統一の影響により前期を上回りました。伸銅のうち電気用伸銅品・加工品は堅調でしたが、銅管の国内事業撤退により、伸銅全体としては前期を下回りました。パッケージ材料は、メモリー用途・特定用途とも減少し前期を下回りました。

主要製品一覧

- 銅条：半導体用銅条、異形条、圧延銅箔他
- リードフレーム：ディスクリット用リードフレーム他
- 伸銅：電気用伸銅品、加工品他
- パッケージ材料：TAB他

*TABはTape Automated Bondingの略です。



電気用伸銅品